

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

625

ML4

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

19.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	470		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		4
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		5
C-RS-FR4-ML-0.71mm-105+105-TG150-HF	50200961	105	L2	6
		710		
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	470		7
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		8
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		9
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		10
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	11

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1930 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik